**軟創學程行動應用與數位互動微學程**

**修業規劃表（ 學年度）**

(日/進) 系（所） 年級： （班）學號： 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **輔 仁 大 學** |
| 選別 | 科目名稱 | 學分 | 預計修課學期請打勾 | 開課單位 |
| 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 延長修業(五上) | 延長修業 (五下) |
| 必修課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軟創學程 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軟創學程 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軟創學程 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軟創學程 |
| 1. 課程規劃：本學程規劃課程學分數為11學分，詳細內容請參考本學分學程課程科目表。
2. 請參考學程課程之開課時間（請注意是否與貴系必修衝堂），妥善規劃每學期您預計的修課課程。
 |
| **學分總計** |  | **學生簽名** |